



产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2020年6月 (209) 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了

TE 产品编号1-178293-2
Header Assembly: Wire-to-Board, 15A, gold or tin plated

TE 产品编号1376352-1
025 I/O PLUG HSG ASSY 8P

TE 产品编号1123343-1
025 REC CONTACT

文档



CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1971885-1_A_c-1971885-1-a.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1971885-1_A_c-1971885-1-a.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1971885-1_A_c-1971885-1-a.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[1-1773703-8_MINI_IO](#)

英文版本

[1-1773703-8_MINI_IO](#)

[1-1773703-8_INDUSTRIAL_MINI_IO](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本